

## 全能王读卡器 II 规格书

### SPECIFICATION FOR MPS

产品型号:	TS-E070
产品类型:	电脑周边 USB 设备
输出规格:	
产品料号:	3.5.2.00.00.07.011
资料编号:	EN-WI-204-01-01
资料版本:	R01/01
发行日期:	2013 年 01 月 08 日

规格书发行签核栏			
核 准	确 认	设 计	制 作
黄志明	徐利兴	李建华	李建华

广东品胜电子股份有限公司 ( 总部 )

地址 : 中国广东.深圳市龙岗区横岗镇六约金塘工业区

电话 : 86-755-28508800/8700/8600      传真 : 86-755-28501688

四川品胜电子有限公司

地址 : 成都市温江区海峡工业园区温泉大道四段 288 号

## 目 录 INDEX

### 1. 产品概述 Products Overview

### 2. 技术参数 Technical parameters

#### 2.1 技术支持 Technical support

2.1.1 操作系统支持 Operating system support

2.1.2 通讯端口支持 Communication port support

2.1.3 存储卡支持 Memory card support

2.1.4 LED 指示读写状态 LED work status indication

2.1.5 读卡方式 Card read way

#### 2.2 产品规格 Product specifications

2.2.1 最小读写速率 Minimum read write speed

2.2.2 电性参数 Electrical parameters

2.2.3 温度条件 Temperature condition

### 3. PCB 规格 PCB specifications

3.1 PCB 外观图 PCB Appearance diagram

3.2 PCB 尺寸图 PCB Size drawing

### 4. 部份组件及要求 important element and requirements

4.1 主控芯片 MCU

4.2 Flash 支持列表 Flash Support list

4.3 卡座 Card Connector

4.4 USB 头 USB Connector

4.4.1 工艺要求 Technological requirements

4.4.2 插拨测试 Inserted dial test

## **5. 可靠性测试 Reliability Testing**

5.1 低温工作测试 Low Temperature Operation Testing

5.2 高温工作测试 High Temperature Operation Testing

5.3 跌落试验 Drop Test

5.4 振动试验 Vibration Test

5.5 特殊要求 Special Requirements

## **6. 产品结构 Product structure**

6.1 产品外观图 Product Appearance

6.2 外壳材质 Enclosure Material

6.3 外壳颜色 Enclosure Color

6.4 外壳结构图 Enclosure Structure

6.5 产品重量 Product Weight

## **7. 产品结构 Product structure**

7.1 产品外观图 Product Appearance

7.2 外壳材质 Enclosure Material

7.3 外壳颜色 Enclosure Color

7.4 外壳结构图 Enclosure Structure

7.5 产品重量 Product Weight

## **8. 产品标签 Product Label**

8.1 标签印刷方式 Label Printing Mode

8.2 标签内容 Label Content

NOTE: 1、Specifications are subject to changes without notice 本规格书内容变更恕不另行通知。

## 版本修改记录 Version Changes Recorded

版本 REV.	修改内容描述 Modify Item Description	日期 Date	修改人 Prepared	核准人 Approved
R01/00	初次发行 Original issue	2012/12/11	李建华	黄志明
R01/01	更换方案,导致文件需重新更新	2013/01/28	李建华	黄志明

## 全能王读卡器 II 规格书

### 1. 产品概述 Products Overview

- ◆兼容USB1.0/USB2.0端口传输
- ◆支持USB大容量存储器传输
- ◆采用瑞昱R特色RTS5152芯片
- ◆支持多系统下读写
- ◆兼容高SD\CF\TF\XD\MS\M2存储卡读写
- ◆支持USB热插拔存储卡识别
- ◆带LED指示读卡器工作状态功能

◆MINI外型, 设计精巧, 易于携带

## 2. 技术参数Technical parameters

### 2.1 技术支持

2.1.1 本读卡器可支持Windows Me/2000/XP/ Vista / UP/ReadyBoost/MAC OS 8.6,

9.X 即以上版本系统

2.1.2 支持USB2.0 Micro 接口连接

2.1.3 SD卡槽:支持SDHC/SD/MMC II/RS MMC/UltraII SD/ Extreme SD  
/Extreme III SD/Mini SD/MMC micro

CF卡槽:支持CFI/CF II/Ultra II CF/Extreme CF/Extreme III CF

TF卡槽: Micro SD/T-FLASH/Micro SDHC

XD卡槽 : XD/XD (H) /XD (M)

M2卡槽 : 支持M2

MS卡槽 : MS /MS MG /MS PRO/ MS Pro MG/MS PRO Duo/ MS PRO-HG  
Duo/ MS Duo/ MS Duo MG

2.1.4 当读卡器连接HOST时, 红色LED处于常亮状态;插入存储卡侦测时蓝色LED闪亮大约0.5秒, 读到存储卡后LED保持常亮状态;当对存储卡进行读/写操作时蓝色LED常闪, 读/写操作结束蓝色LED保持常亮状态, 红色一直处在常亮状不变.

2.1.5 只支持单盘符显示, 单卡读写操作, 不支持多卡操作, 支持热插拨存储卡识别

### 2.2 产品规格

#### 2.2.1 最小读/写速率

项目 \ 型号容量	SD (4G)	MS (2G)	CF (4G)	TF (8G)	M2 (2G)	XD (2G)
读 KB/S	20000 (Min)	15000 (Min)	20000 (Min)	20000 (Min)	15000 (Min)	1300 (Min)
写 KB/S	4000 (Min)	4000 (Min)	4000 (Min)	4000 (Min)	2000 (Min)	40 (Min)

#### 2.2.2 电性参数

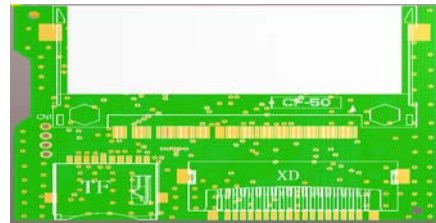
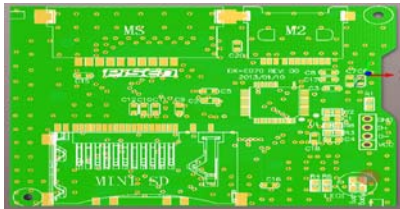
待机	最大 70mA
读卡	最大 160mA
写卡	最大 160mA

### 2.2.3 温度条件

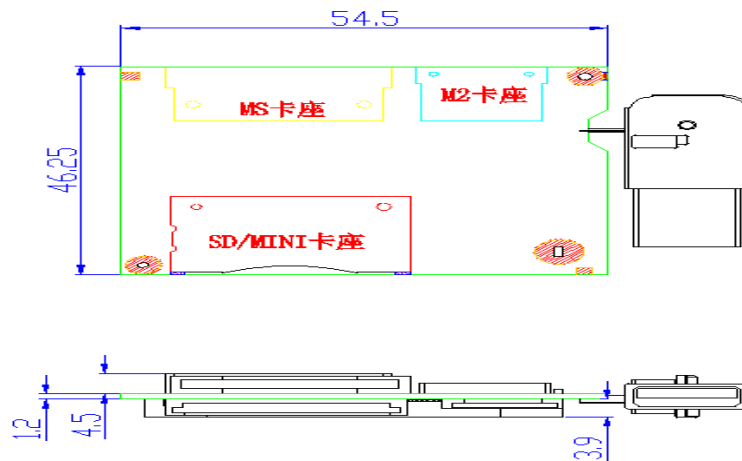
环境	温度值
工作环境	0℃——60℃
存储环境	-65℃——+150℃

## 3. PCB规格PCB specifications

### 3.1 PCB外观图



### 3.2 PCB尺寸图 单位：MM



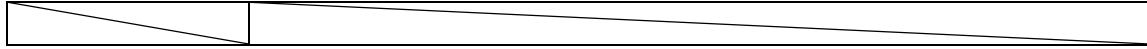
## 4. 部份组件与要求important element and requirements

### 4.1 主控芯片

主控芯片采用瑞昱公司的RTS5152 USB2.0芯片, 向下兼容USB1.0

### 4.2 Flash 支持列表

品牌	型号



### 4.3 卡座

卡座铁壳的需镀镍，内部PIN针镀金3u以上。疲劳度测试3000次以上，无接触不良现象；5%浓度盐雾实验，24小时无生锈现象

### 4.4 USB头

4.4.1 铁壳需镀镍，内部PIN针镀金3u以上。疲劳度测试3000次以上，无接触不良现象；5%浓度盐雾实验，24小时无生锈现象

4.4.2 USB 插头与 USB 插座之间进行插拔 ,插拔速率的速率不超过 30 次/min 时 ,将 USB 插头完全插入连接插座所需的力最大不能超过 35N , 将连接插头从连接插座中完全拔出所需的力量 , 最小不得小于 10N , 循环插拔测试 3000 次以上 , 功能正常 ; 插拔 50 次后测试插拔力 : 插入力不得小于 30N, 拔出力不得小于 0.7N

## 5. 可靠性测试 Reliability Testing

### 5.1 低温工作测试 Low Temperature Operation Testing

在测试环境温度为  $0\pm 3^{\circ}\text{C}$  , DUT 能正常使用无任何功能性不良。

### 5.2 高温工作测试 High Temperature Operation Testing

在测试环境温度为  $+60\pm 3^{\circ}\text{C}$  的情况下,DUT 能正常使用无任何功能性不良。

### 5.3 低温存储测试 Low Temperature Storage Testing

将测试设备设定为温度  $-60\pm 3^{\circ}\text{C}$  , 降温速率为  $1^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$ 。将 DUT 放入测试设备并保温 8 小时 , 然后拿出 DUT 放在  $25\pm 3^{\circ}\text{C}$  环境温度下放置 1 小时使其温度达到稳定。测试 DUT 能正常工作

### 5.4 高温存储测试 High Temperature Storage Testing

将测试设备设定为温度  $+145\pm 3^{\circ}\text{C}$  , 升温速率为  $1^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$ 。将 DUT 放入测试设备并保温 8 小时,然后拿出 DUT 放在  $25\pm 3^{\circ}\text{C}$  环境温度下放置 1 小时使其温度达到稳定。测试 DUT 能正常工作

## 5.5 跌落试验 Drop Test

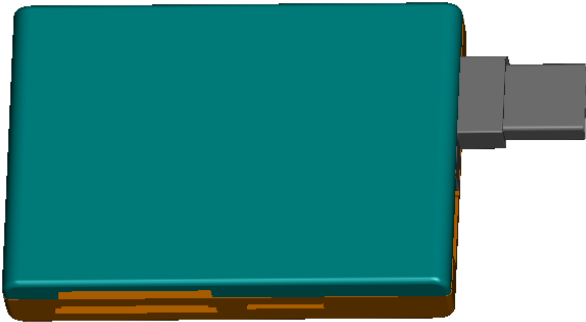
跌落测试高度为 150cm，并跌落到厚度为 20mm 的硬木板上每面各 2 次，跌落测试后 DUT 应无明显功能性损坏及外壳开裂现象。

## 5.6 振动测试 Vibration Test

扫描频率 10 ~300Hz，加速度:1.0G(位移: 3.5mm)，X、 Y、 Z 三个垂直坐标轴向各振动 30 分钟，应无功能性损坏及机体和外包装刮伤/破损现象。

# 6. 产品结构 Product structure

## 6.1 产品外观图 Product Appearance



73\*51\*14

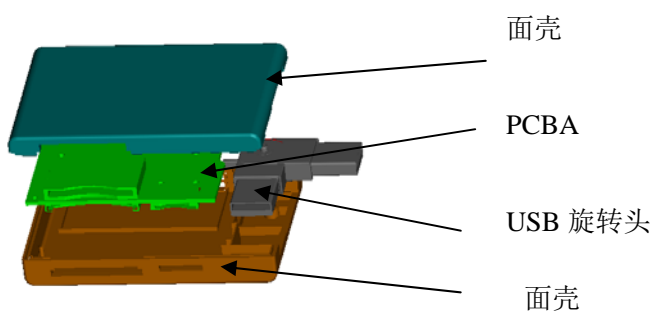
## 6.2 外壳材质 Enclosure Material

面壳，底壳均为 ABS

## 6.3 外壳颜色 Enclosure Color

面底壳均为苹果白

## 6.4 产品爆炸图 Enclosure Structure





## 6.5 产品重量 Product Weight

27 克

## 7. 产品标签 Product Label

### 7.1 标签印刷方式 Label Printing Mode

将标签以丝印方式印于产品指定位置。

### 7.1 标签内容 Label Content

为了使产品标识更加完整和符合安规要求，所标签内容必须包含下列内容：

- A. 产品类型：存储类
- B. 产品名称：全能王读卡器 II
- C. 产品型号：TS-E070
- D. 输入参数：PC USB 规范
- E. 输出参数：
- F. 执行标准：
- G. 警示语：
- H. 安规符号：
- I. 环保符号：
- J. 其它符号：

**▲规格书到此结束 END OF THE SPECIFICATION.**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Development Boards & Kits - Other Processors](#) category:*

*Click to view products by [Pisen](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[KIT\\_AURIX\\_TC233LP\\_TRB](#) [EVB-MEC1418MECC](#) [SPC56XVTOP-M](#) [ADZS-BF506F-EZLITE](#) [ADZS-SADA2-BRD](#) [20-101-1252](#)  
[T1023RDB-PC](#) [20-101-1267](#) [ML610Q174 REFERENCE BOARD](#) [MPC574XG-MB](#) [BSC9132QDS](#) [C29XPCIE-RDB](#) [KIT\\_TC1793\\_SK](#) [CC-](#)  
[ACC-18M433](#) [P1010RDB-PB](#) [P1020RDB-PD](#) [P2020COME-DS-PB](#) [STM8S/32-D/RAIS](#) [T4240RDB-PB](#) [TRK-USB-MPC5604B](#) [TWR-](#)  
[56F8200](#) [SPC58XXADPT176S](#) [MAX1464EVKIT](#) [TRK-MPC5606B](#) [RTE510Y470TGB00000R](#) [STM8128-MCKIT](#) [MAXQ622-KIT#](#)  
[YRPBRL78G11](#) [SPC58EEMU](#) [QB-R5F10JGC-TB](#) [YQB-R5F11BLE-TB](#) [SPC564A70AVB176](#) [RTE5117GC0TGB00000R](#) [QB-R5F100LE-](#)  
[TB](#) [YR0K50571MS000BE](#) [YQB-R5F1057A-TB](#) [QB-R5F104PJ-TB](#) [CC-ACC-ETHMX](#) [LFM34INTPQA](#) [SPC563M64A176S](#) [P1021RDB-PC](#)  
[SPC58XCADPT176S](#) [RTE510MPG0TGB00000R](#) [YRPBRX71M](#) [LFMAJ04PLT](#) [KITAURIXTC234LPSTRBTOBO1](#) [OV-7604-C7-](#)  
[EVALUATION-BOARD](#) [ZL3ETH](#) [NEXYS A7-100T](#) [NEXYS A7-50T FPGA TRAINER BOARD](#)